

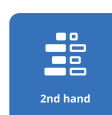
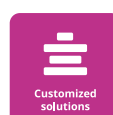
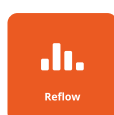


B-系列 BERNOLLI-B12

用於先進封裝和半導體生產
最先進的回流焊接系統

確保產品焊接過程中的平整
適用於極薄的產品和應用

最節能與成熟的回流焊接系統
配備了專有的負壓系統
三軌輸送系統



B-系列 BERNOLLI B12

- 低壓回流焊確保平整焊接無翹曲（應用於薄板產品）
- 吸力強勁，可吸厚達0.5mm的薄板
- 三軌輸送滿足高產出的需求
- 軌道寬度自由調節，不同產品及時轉換
- 上下加熱提高熱效率

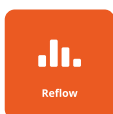
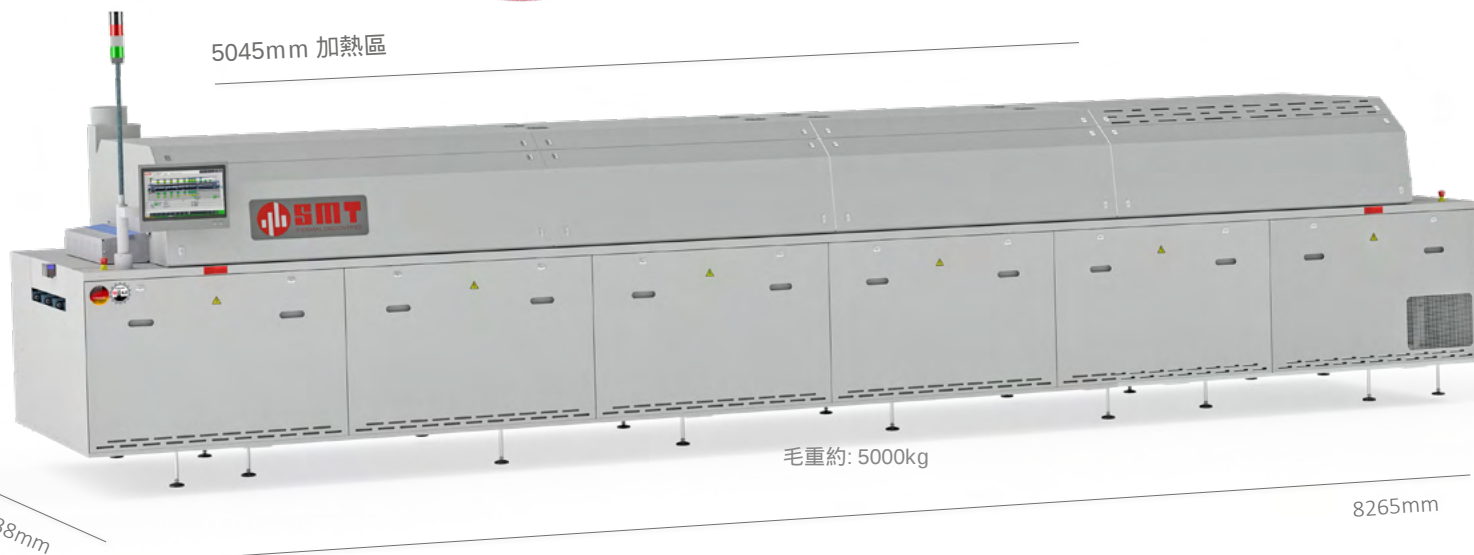
- 全熱風對流加熱系統與節能Profiling Plus應用
- 強勁的四區冷卻系統讓產品得到充分的冷卻
- 在同一制程中靈活應對不同的產品
- 風扇速度控制熱傳遞

- 智能氮氣控制系統
- 配備成熟的 ABS 清潔系統
- 優化的焊錫管理系統

- 低維護成本



全過程持續的吸力
確保產品平整焊接



Reflow



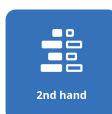
Vacuum



Temperature treatment



Customized solutions



2nd hand



Advanced Packaging



SMT
THERMAL DISCOVERIES

Distributor:

SMT Thermal Discoveries
Roter Sand 5-7
97877 Wertheim - Germany
t: +49 (0)9342 970 0
www.smt-wertheim.com